



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 系统封装与集成研发中心

以硅通孔为核心的三维系统集成技术及应用

文献类型: 成果

作者 孙鹏³; 戴风伟^{3,1}; 肖智轶³; 于大全³; 张文奇³; 李君^{3,1}; 曹立强^{3,1}; 黄小花³; 耿菲³; 王启东^{3,1}

获奖日期 2018

文献子类 北京市科学技术奖

奖励等级 二等奖

语种 中文

源URL [http://159.226.55.107/handle/172511/19286]

专题 微电子研究所_系统封装与集成研发中心

作者单位 1.华天科技(昆山)电子有限公司
2.华进半导体封装先导技术研发中心有限公司;
3.中国科学院微电子研究所;

推荐引用方式 孙鹏,戴风伟,肖智轶,等. 以硅通孔为核心的三维系统集成技术及应用. . 2018.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览	下载	收藏
61	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。